

經濟部 函



機關地址：106臺北市大安區信義路三段41-3號

聯絡人：曾思源

聯絡電話：(02)2754-1255 分機2172

電子郵件：syztzeng3@ida.gov.tw

407

407台中市西屯區協和里工業37路27號
3樓

受文者：台灣工具機暨零組件工業同業公會

發文日期：中華民國115年9月8日

發文字號：經授產字第11500720770號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：遙控無人機採購作業指引(晶片封裝測試須於中港澳以外之地區完成)

主旨：檢送行政院公共工程委員會（下稱工程會）最新修訂之「遙控無人機採購作業指引」，請貴聯盟及公會務必轉知所屬國內外廠商成員加強宣導，以避免因認知落差導致違規，請查照。

說明：

一、依據工程會115年9月4日工程企字第1150100423號函辦理。

二、工程會本次修訂之「遙控無人機採購作業指引」，係「陸、國產化及非紅供應鏈策略」之「四、無人機模組及零組件之國產及非紅要求」第（三）項，修訂規定如下：

（一）基於晶片封裝測試為一重要製程，且有影響國安（資安）風險之虞，又為避免特殊時期可能斷鏈之風險，晶片封裝測試須於中港澳以外之地區完成。

正本：遙控無人機海外商機聯盟、台灣區航太工業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會

副本：經濟部產業發展署

部長 龔明鑫

本案授權產業發展署執行